



平成 30 年 10 月 10 日

各 位

会社名 株式会社 マルマエ  
代表者名 代表取締役社長 前田 俊一  
(コード番号：6264 東証第二部)  
問合せ先 取締役管理本部長 藤山 敏久  
(TEL. 0996-64-2900)

### 中期事業計画の策定に関するお知らせ

当社は、2019年8月期から2021年8月期までの3年間を計画期間とする新しい中期事業計画「Innovation2021」を策定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

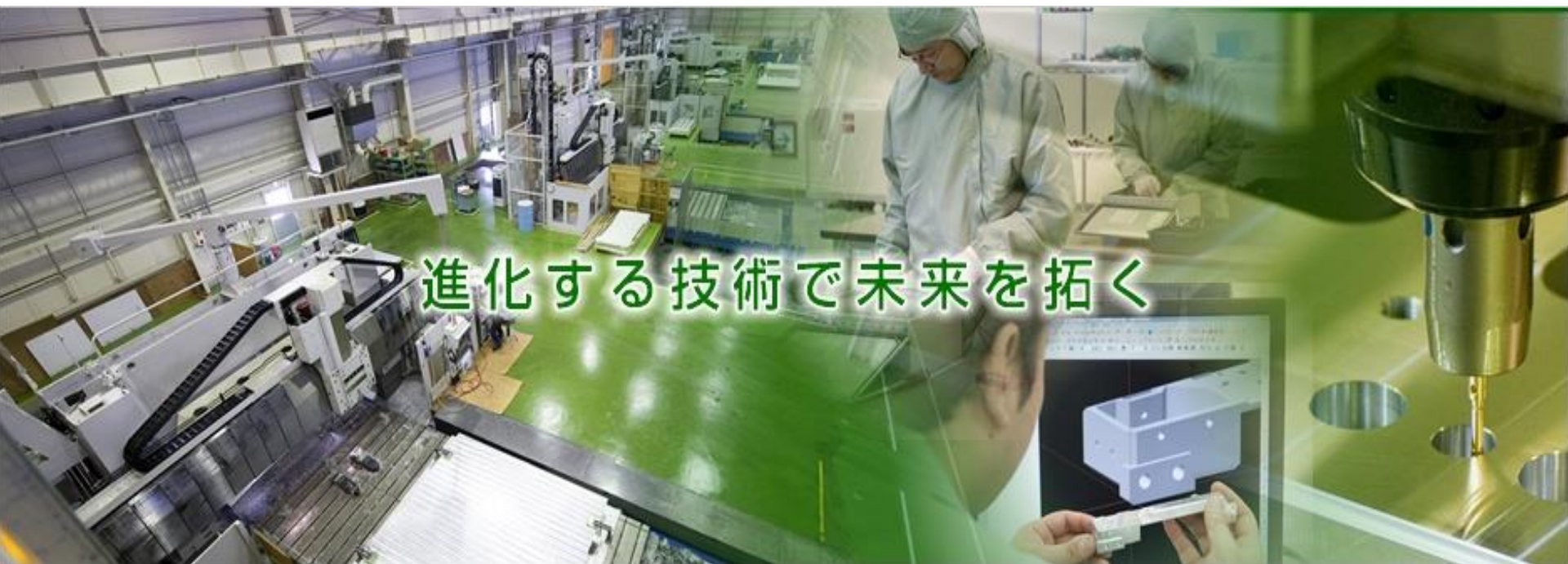
1. 名称 中期事業計画「Innovation2021」
2. 期間 2018年9月1日～2021年8月31日（2019年8月期から2021年8月期）
3. 中期事業方針 (1) 方針は「革新」  
生産手法や管理手法を革新することで持続できる企業を目指す。  
(2) 数値目標は、計画期間中に、売上高80億円、営業利益24億円を達成する。  
(3) 新たな経営指標としてROICを採用する。  
資産ベースROIC：20%以上  
負債ベースROIC：15%以上
4. 株主還元 配当性向は、30%以上を目標とし、年間最低配当額は10円とする。  
※ただし、最終損益が赤字となる場合は見直しを行う

中期事業計画「Innovation2021」の詳細につきましては、添付資料をご参照ください。

以 上

東証二部(TSE):6264

# 中期事業計画「Innovation 2021」 (2019年8月期～2021年8月期)

2018年10月10日  
株式会社 マルマエ

進化する技術で未来を拓く

1. 事業概要	.....	3 P
2. 前中期事業計画の総括	.....	6 P
➤ 目標と評価	.....	7 P
➤ 成果	.....	9 P
3. 新計画「Innovation2021」	.....	12 P
➤ 目標	.....	13 P
➤ 市場環境分析	.....	14 P
➤ 戦略	.....	18 P
➤ R & D	.....	23 P
➤ 配当政策	.....	24 P

# 1. 事業概要

当社製品は世界中で半導体・FPD製造装置の心臓部を支えています

主要工程  
エッチング  
CVD  
コータ/デベロッパ  
スパッタ  
枚葉洗浄  
アッシング  
ウエハーボンディング  
イオン注入  
アニール

主要製品  
真空チャンバー  
シャワーヘッド  
排気版  
静電チャック  
ヒーター類  
上部電極  
ターゲット  
搬送系パーツ類  
各種真空パーツ類

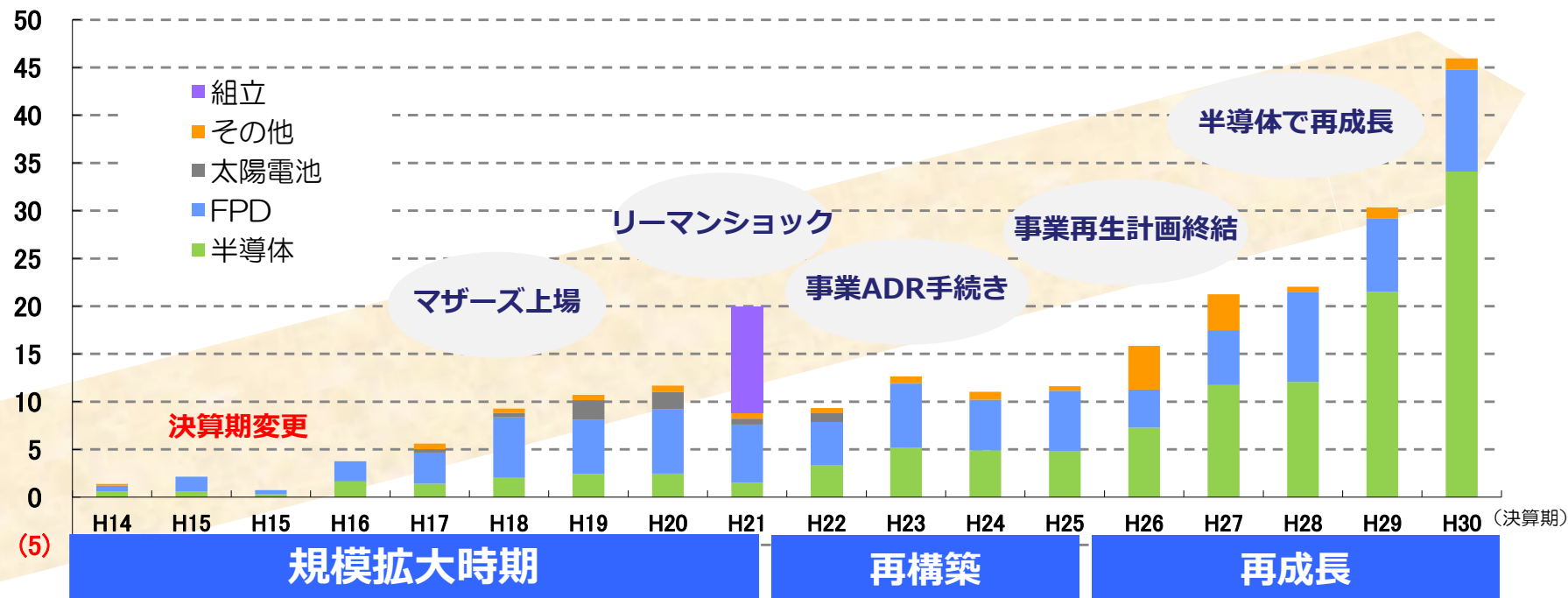
※画像はイメージです



# 1. 事業概要

事業成長と成長ドライバー ～技術力をベースに変化し、成長を継続～

売上高 (単位：億円)



(成長ドライバーの変遷)

## 2. 前中期事業計画の総括

# 中期事業計画 Evolution2018

## 数値目標

連結売上40億円 営業益10億円



達成 (売上高45.8億、営業利益12.3億)

## 株主還元

配当性向35%以上 (順次向上)



未達 (21.7%→19.7%→27.8%) ※設備投資を優先

## 全般

期間中に東証一部への市場変更※



未達 期末現在東証二部

※東証二部経由も想定



# 中期事業計画 Evolution2018

事業分野	目標	結果
既存事業	<ul style="list-style-type: none"><li>・半導体分野の伸長</li><li>・生産性向上</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・3D NAND需要中心に拡大実現</li><li>・生産性の改善実現</li></ul>
M&A	<ul style="list-style-type: none"><li>・中小を中心にシナジー有り 又は半導体のリスクヘッジ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・自社投資を優先し中断</li></ul>
新分野	<ul style="list-style-type: none"><li>・作業補助・介護ロボット等</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・鹿児島大学とリハビリ装置共同研究</li><li>・医師主導で実患者10名に延べ100時間の 実証試験を実施済み</li></ul>
新分野	<ul style="list-style-type: none"><li>・新しい技術の取得</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・電子ビーム溶接（EBW）への取組開始</li></ul>

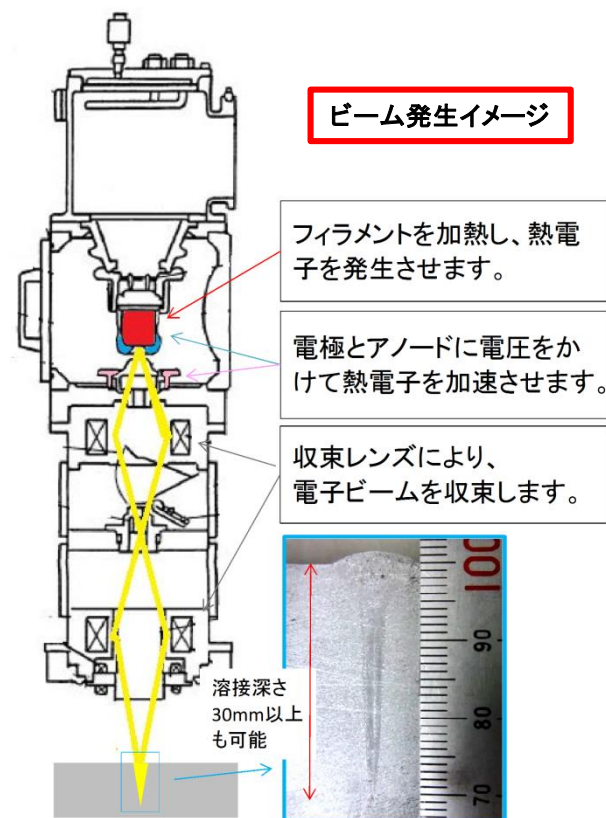
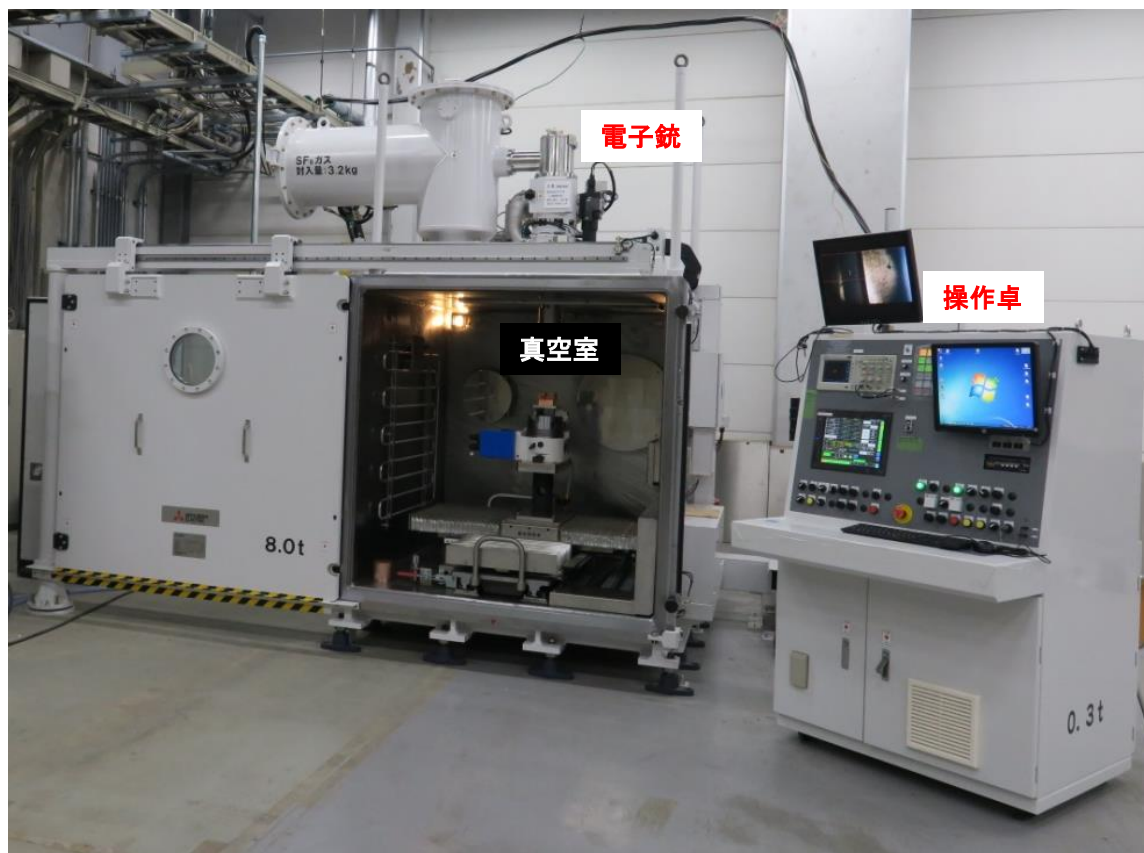
## 2.前中期事業計画の総括



### 成果 ～電子ビーム溶接 (EBW)～

#### 特徴と狙い

- ・真空中で各種金属を高品位溶接
- ・半導体製造装置の真空パーツの受注品種拡大に貢献
- ・新たな事業の柱へと育成



## 成果 ～リハビリ装置～

### 特徴と狙い

- 脳卒中起因の片麻痺に対するリハビリ装置を鹿児島大学と共同研究
- 促通反復療法「川平法」を自動化、新たな事業の柱へと育成狙う
- 上腕全体のリハビリを目指し、手首リハビリから着手





## 2.前中期事業計画の総括

成果 ～新事業所取得～

### 特徴と狙い

- ・パイオニアプラスマディスプレイ株式会社より休止工場を譲り受け半導体製造装置向け真空パーツ生産に活用
- ・自動化による高効率生産に取り組む



#### Point

- ✓ 敷地面積7.2万㎡
- ✓ 既存工場込みで取得
- ✓ 既存工場の構造
  - ・ クリーンルーム2層構造
  - ・ 1階11,000㎡
  - ・ 2階13,750㎡
  - ・ 1階部分を部品工場へ転換
  - ・ 5階建ての事務棟
- ✓ IoTを活用した生産
- ✓ 2018年4月末一部稼働

## 3. 新計画「Innovation2021」

※今期より当社は年度表記を西暦に変更しました

## 目標

# 新中期事業計画 Innovation2021

数値目標

売上高80億円 営業益24億円

ROIC

資産ベースROIC 20%  
負債ベースROIC 15%

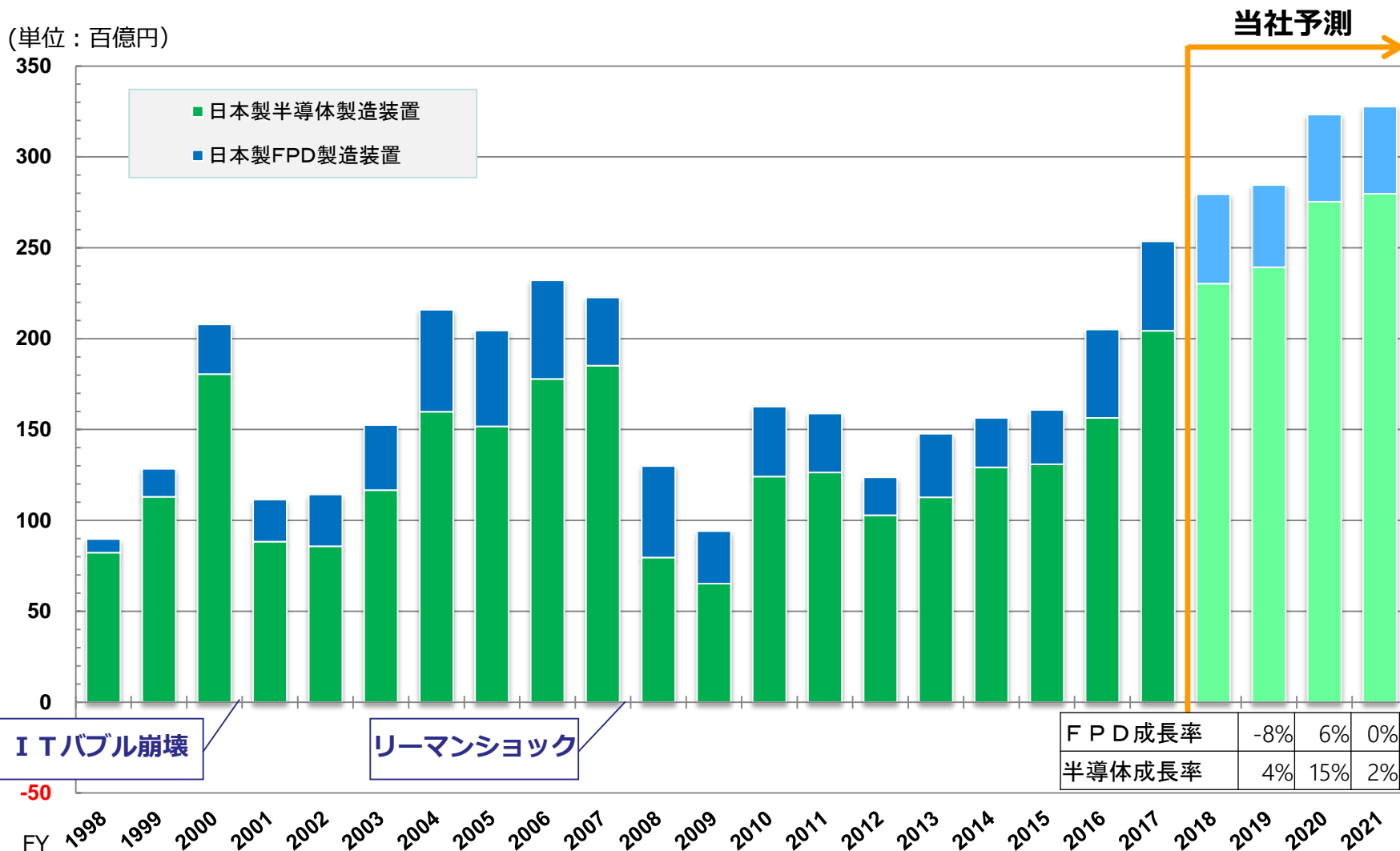
配当性向

配当性向 30%以上目標  
最低配当額年間 10円※

※ただし最終損益が赤字となる場合は見直しを行う

# 3.新計画「Innovation2021」

## 市場環境分析



※本資料の予測値は市場環境を基に当社が予測したもので、WFE成長と連動する前提です。



# 3.新計画「Innovation2021」

## 市場環境分析 ～中期的な販売分野別の環境と方針～

### 半導体分野

- ◆ データ通信量増加と関連するサーバー需要が主なドライバー
- ◆ SPEはロジック→NAND→DRAM間で循環し成長続く見通し
- ◆ 生産力強化によりエッチングとCVD工程でシェア拡大狙う

### FPD分野

- ◆ 中国向けG10.5液晶以外は停滞見込み
- ◆ 投資減速も多工程の取り込み狙う（コーデベ⇒エッチング拡大）
- ◆ EBWと輸送を活かし前後工程までワンストップ受注の強化

### その他分野

- ◆ スマートフォン向けは停滞、太陽電池等新エネ狙う
- ◆ 新分野の市場開拓と医療機器の事業化目指す
- ◆ EBWに続く新技術取得で新分野受注促進

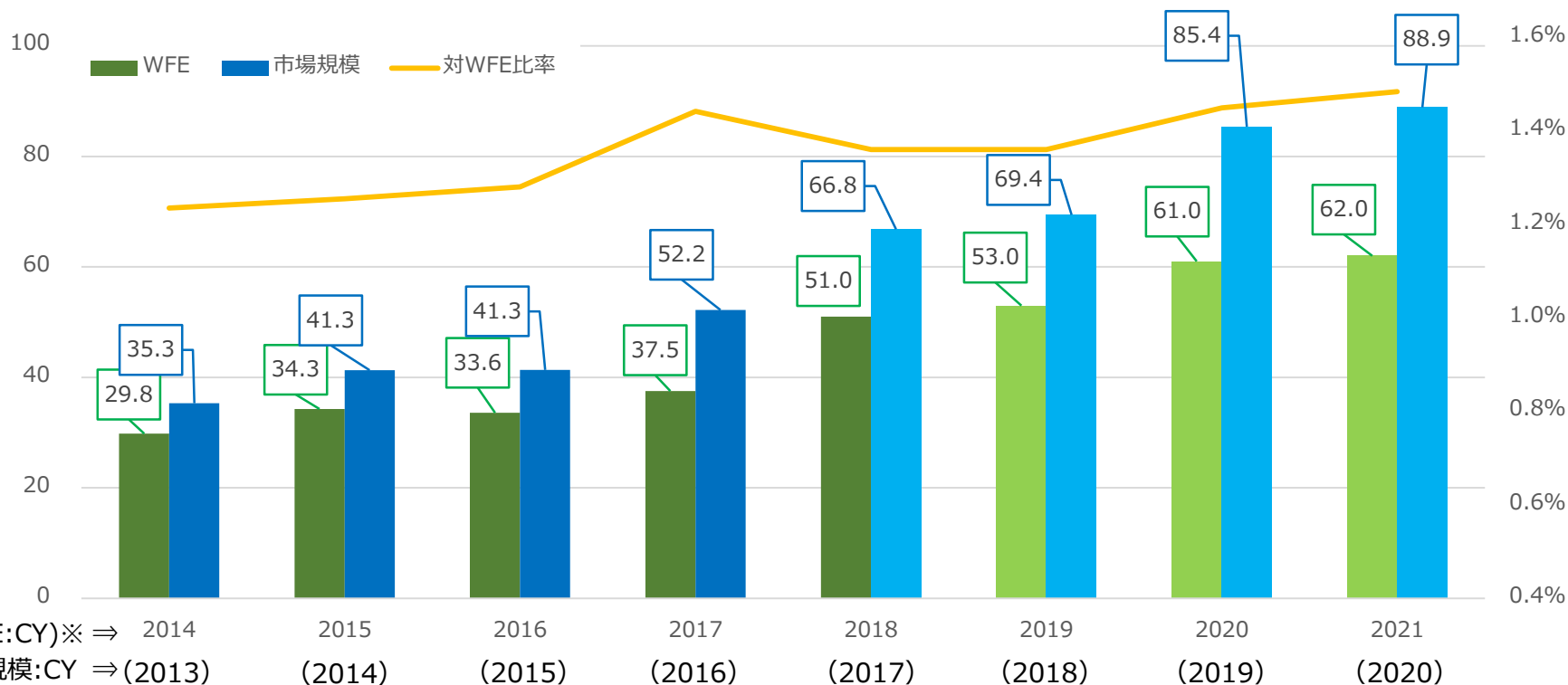
# 3.新計画「Innovation2021」

## 市場環境分析

(WFE 単位：B US\$)  
(市場規模 単位：十億円)

WFE市場と当社の属する市場の関連性 ※薄い色は当社予測

(対WFE比率)



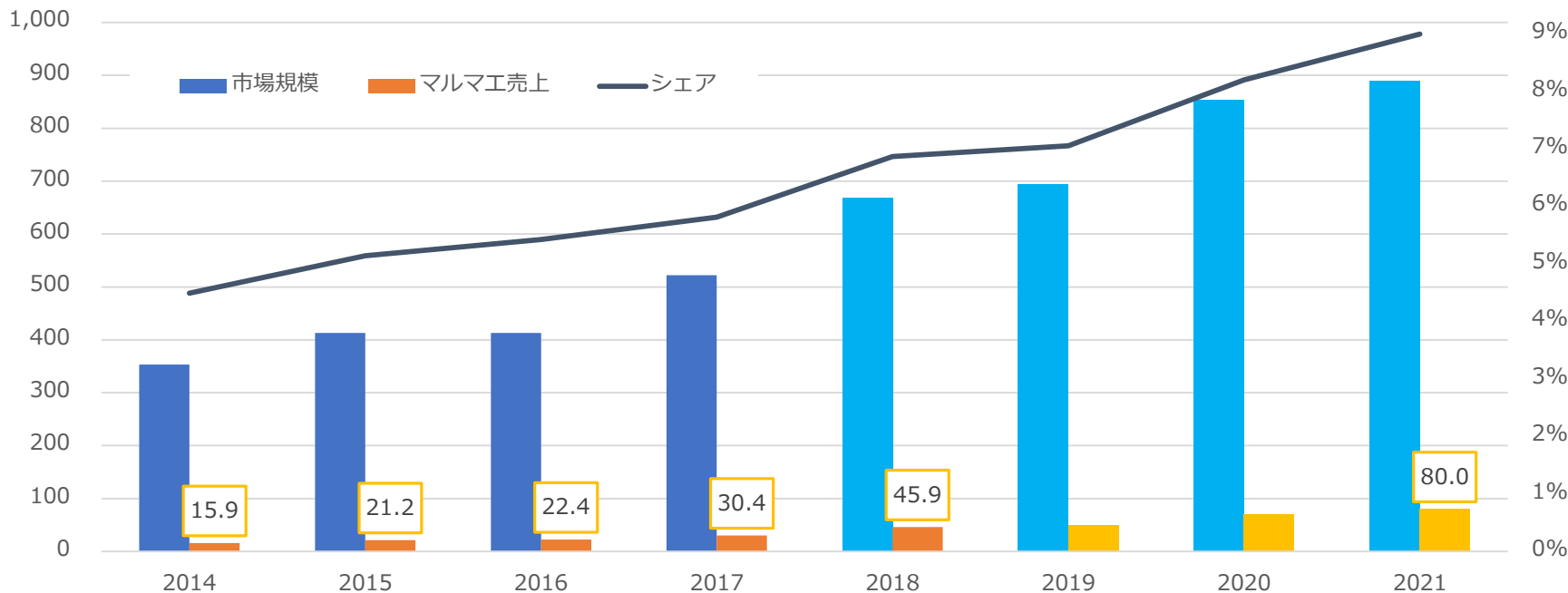
- ✓ 市場規模データは、当社と類似した真空パーツを生産する企業で、当社が認識する一部（当社含み25社）の企業について、各暦年に属する決算期末ごとの売上高を帝国データバンクの情報を基に集計した資料です。
- ✓ 2018年のデータは、25社中12社が当年度決算未反映のため、類似業者から推測した当社予測数値となっております。
- ✓ 各社の決算期末が属する暦年で集計しておりますが、WFEデータは過去の市場規模データとの相関性を考慮し、市場規模データより後に1年ずらして表示しております。（当社の属する市場が先行）

# 3.新計画「Innovation2021」

## 市場環境分析

(単位：億円)

市場規模と当社シェア ※薄い色は当社予測



### 成長性

- ✓ 当社の属する業界は、主に半導体製造装置市場に関連し、変動しながら成長するシクリカルグロースな業界です。
- ✓ 当社は、この業界の中で、生産力を伸ばし継続的にシェア拡大しながら市場成長を超える成長を実現しています。

## 環境

## SPE市場に関連する今後のドライバー

サーバー需要増加

+

SSD価格低下

=

NAND増加  
DRAM増加  
ロジック増加

## ターゲット

- ・エッチング
- ・CVD
- ・ALD
- ・洗浄

## 5G通信によるデータ量の爆発的増加

IoT機器

自動車のIoT化

携帯端末のストック  
50億台以上

ゲーム市場拡大  
アプリ化+Cloud

動画配信

- Topic
- ✓ サーバー需要のボトルネックとなっていたMPU投資の再開を観測
  - ✓ メモリ需要は遅れて改善予想
  - ✓ ロジックファウンダリ投資再開

## 環境

## FPD市場の見通しと戦略

2020年まで中国のG10.5投資継続  
も中小型パネル投資急減速

マイナス

テレビ向け有機ELの拡大

プラス

米国内で中小型パネル投資可能性

プラス

投資案件減少でも  
別工程と前後工程  
受注で拡大狙う

未受注の  
エッチャー  
受注開始

+

大型EBW  
開始  
工程拡大

新計画あるも先細り懸念

## 革新

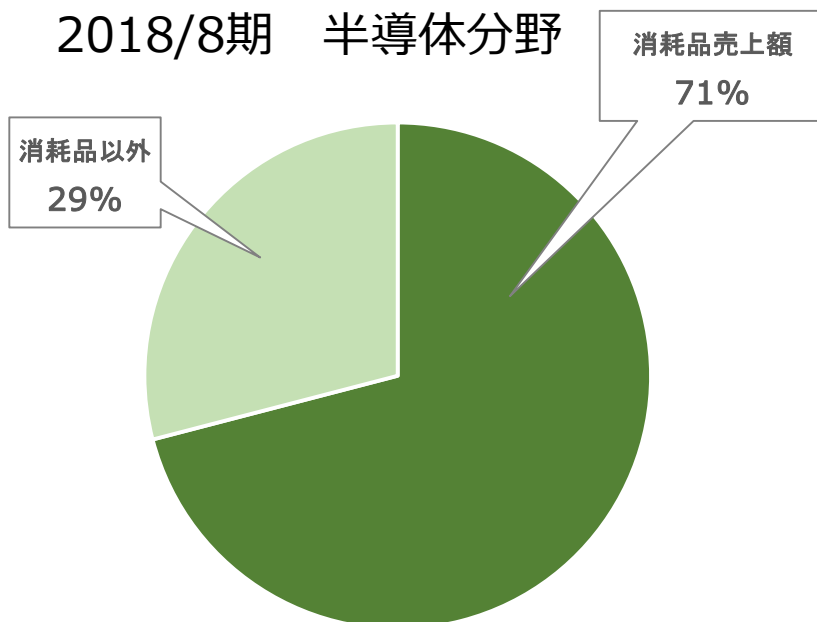
## 新しい付加価値創造

分野	項目	内容
電子ビーム溶接 (EBW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 客先と共同で日本最大クラス大型電子ビーム溶接機 (EBW) 設置 ※本件につきましては、顧客情報に関連し詳細の開示はできません。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 従来の半導体分野向けの小型EBWに加え、FPD分野向けの大型EBWの設置で新たにエッチング用チャンバーの受注開始</li> <li>✓ EBWなど前後工程も受注</li> </ul>
自動化	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 独自の自動化システムによる生産の自動化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 難易度の高い真空部品のハンドリングを自動化し、無人稼働推進</li> </ul>
オープンイノベーション	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 表面処理・FSW・熱処理</li> <li>✓ 組立等の部品関連技術</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 出水事業所をハブとして他社と協調し、半導体製造装置部品の一貫生産を進める</li> </ul>

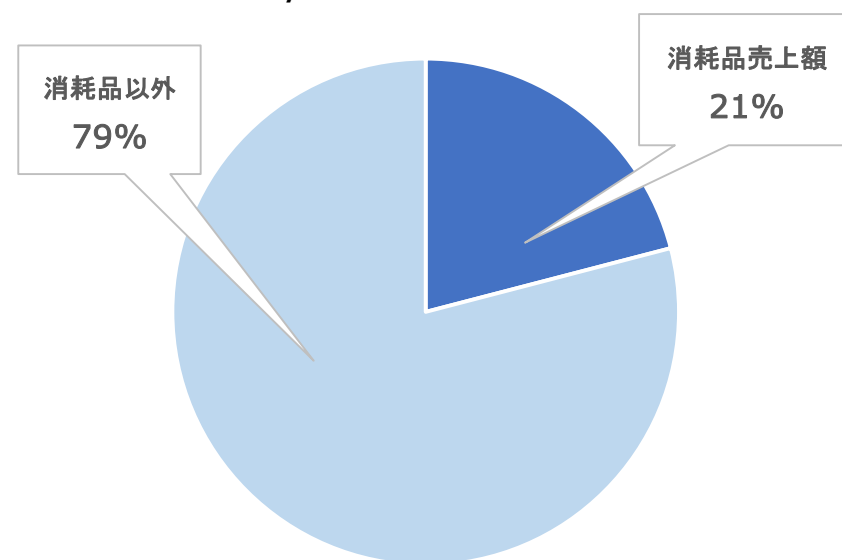
# 3.新計画「Innovation2021」

## 戦略 ～消耗品受注の拡大～

2018/8期 半導体分野



2018/8期 FPD分野



### 消耗品需要

- ✓ 当社は真空パーツの中でも、プラズマにさらされる消耗品の受注に注力しております。
- ✓ 消耗品需要は、大きな変動にさらされる新規装置の需要動向と違い、半導体工場の稼働が上がれば需要が増えることから事業の安定化につながります。
- ✓ 当社の消耗品のくくりには、新規装置に装着あるいは添付される部品も含まれることから、完全な消耗による需要のみではありません。



## 設備投資

## 自動化と生産方法の革新

年度	2018/8	2019/8	2020/8	2021/8
設備投資額 2018以降は予想	24.5億円	18.5億円	7億円	未定
減価償却（原価） 2018以降は予想	335百万円	609百万円	690百万円	640百万円

### 設備投資

- ✓ 2019年8月期は出水事業所自動化設備、高尾野事業所第8工場、大小EBW等  
※生産設備は市場動向を見ながら実施
- ✓ 2020年8月期は自動化設備増強

### 生産能力

- ✓ 2017年8月期末では322百万円/月の生産能力  
半導体分野191百万円、FPD分野107百万円
- ✓ 2018年8月期末では477百万円/月まで増加  
半導体分野370百万円、FPD分野107百万円
- ✓ 2019年8月期は522百万円/月まで増加予定  
※金額は限界利益ベースです。EBWは未算入。  
生産能力は機械能力を単純合算した最大能力なので、分野および機械ごとの稼働率低下により売上には直結しません

## R & D

### 目標

- ・ 2021年8月期まで医療機器部門の事業化  
(現リハビリ装置の医療機器認証取得、医療機器販売)
- ・ 2021年8月期まで自社のFA技術構築と技術者の育成  
(自社システムの構築によりFA技術での生産性革新)



実証試験用評価機

### タイムスケジュール

- ✓ 2019年8月期に認証申請用試作、認証申請
  - ✓ 2020年8月期に安全性・性能試験完了
  - ✓ 2021年8月期までに医療機器認証取得  
医療機器販売開始
- ※申請と並行し、別部位リハビリ装置開発

### 自動化

- ✓ 2019年8月期は自動化の生産性評価指標構築
- ✓ 2020年8月期は自動化製造ライン内製化
- ✓ 2021年8月期は自社システム構築

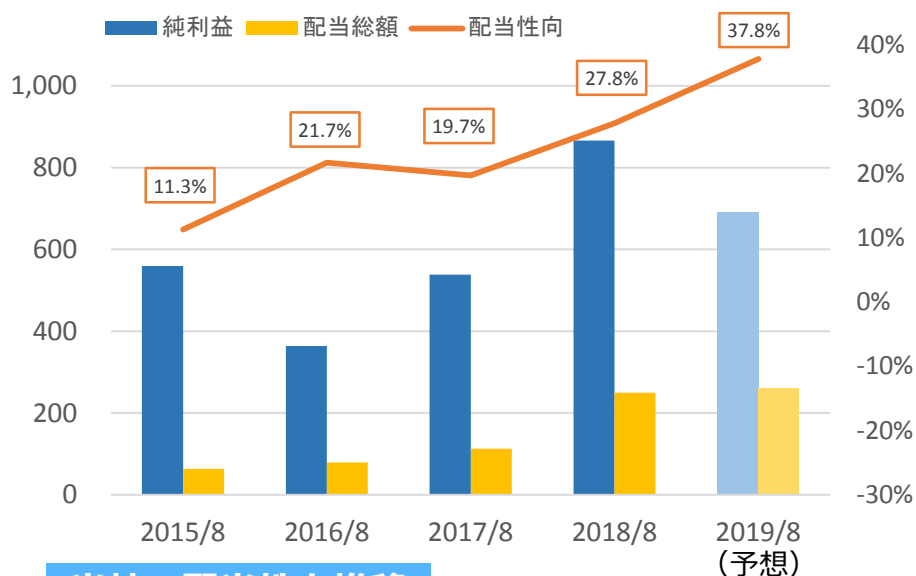
### 新技術

- ✓ EBWに続く新技術の獲得

### 配当

### 実績と予想

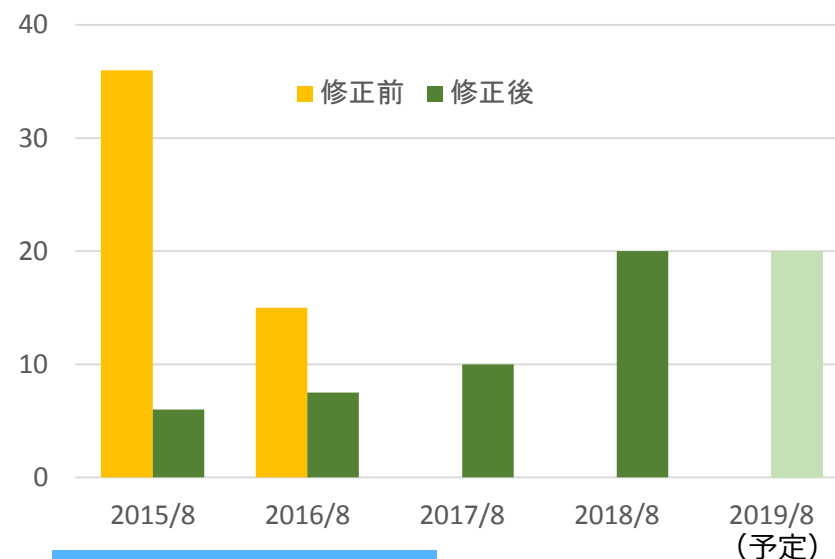
当期利益と配当性向



#### 当社の配当性向推移

- ✓ 2018年8月期の期首見通しでは35.6%予想も、期中の上方修正後に配当額を据え置きし、結果27.8%にとどまった
- ✓ 2019年8月期は前期配当額据置で37.8%予想
- ✓ 最低配当額を年間10円とし、安定配当も意識

一株当たり配当額



#### 当社の配当額推移

- ✓ 2015年9月に3分割、2017年3月に2分割している。グラフは修正前と修正後併記
- ✓ 2018年8月期は上期10円下期10円
- ✓ 2019年8月期も上期10円下期10円を予定

新中計期間は30%以上の配当性向予定

本資料に掲載された情報、及び、口頭によって説明された実現していない内容に関しては、ある一定の仮定の元に予想された見通しであり、マルマエ経営陣の判断など不確定要素を含んでおります。

本資料は、株主・投資家などの皆様にマルマエの現況と経営方針をご理解いただくために作成されたものであり、利用者に対して、当社株式の購入・売却など投資判断を提供するものではありません。投資に関する責任は負いません。

数値などの情報には注意をはらっておりますが、掲載の内容については未監査の数値も多く、確度を保証するものではありません。また、掲載された情報、またはその誤りについて、その理由に関わらず、当社は一切責任を負うものではありません。

本資料に関するお問合せ先

株式会社マルマエ 管理本部総務課 IR担当

ir@marumae.com

TEL 0996-64-2900 FAX 0996-64-2863